第一图书网, tushu007.com

<<纳米封装>>

图书基本信息

书名：<<纳米封装>>

13位ISBN编号：9787111400363

10位ISBN编号：7111400364

出版时间：2012-12

出版时间：机械工业出版社

作者：罗小兵

页数：461

字数：642000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

本书汇集了纳米封装领域主要专家学者的最新研究成果，内容丰富，全面深入，几乎涵盖了纳米封装领域的所有方面，如材料制备、材料性能、表面改性、工程应用、数学模拟和超越摩尔定律的技术问题等。

本书为电子封装领域的从业者和研究人员提供了一份及时而重要的技术资料。

第一图书网, tushu007.com

书籍目录

译者序
原书序
原书前言
撰稿人
名词术语
第1章　纳米封装——纳米技术和电子封装
第2章　模拟技术和应用
第3章　分子动力学模拟在电子封装领域的应用
第4章　脱层建模的进展
第5章　纳米颗粒特性
第6章　纳米颗粒制备
第7章　纳米颗粒高k值介电复合材料：机遇与挑战
第8章　纳米结构电阻材料
第9章　纳米颗粒磁心电感器：设计、制造和封装
第10章　纳米导电胶
第11章　微孔填充中的纳米颗粒
第12章　导电微结构材料与技术
第13章　Sn-Ag系无铅焊料中的纳米颗粒研究
第14章　用于细间距电子元器件的纳米底胶
第15章　碳纳米管的合成与表征
第16章　纳米电子器件中碳纳米管的性能
第17章　用于微系统热管理的碳纳米管
第18章　使用多壁碳纳米管封装的收发器电磁屏蔽
第19章　单壁碳纳米管增强焊料63Sn-37Pb和Sn-3．8Ag-0．7Cu的性能
第20章　电子封装中的纳米线
第21章　微电子封装中应力工程柔性互连的设计和发展
第22章　纳米尺度硅逻辑器件中倒装芯片封装：挑战和机遇
第23章　纳米电子学前景：应用、技术和经济
参考文献

编辑推荐

《国际信息工程先进技术译丛·纳米封装：纳米技术与电子封装》编者是电气和电子工程师学会（IEEE）纳米技术委员会的成员，许多撰稿人都是电气和电子工程师学会／封装与制造技术学会的会员。
他们及时提出并总结了了这一重要议题，为电子封装及其材料的发展做出了卓越贡献。
从内容上看，《国际信息工程先进技术译丛·纳米封装：纳米技术与电子封装》不仅收录了国际知名学者对封装材料的最新见解，并且系统论述了纳米封装中的计算机建模技术，介绍了纳米颗粒和碳纳米管的应用，包括纳米印制、焊膏印制、微波加热、底部填充胶和各向异性导电薄膜，分子建模技术在碳纳米管热特性、湿度扩散，热循环和脱层失效等方面的应用，纳米颗粒的熔点降低，库伦阻塞、界面扩散效应、光吸收、烧结及制备方法，基于纳米颗粒的高介电薄膜，激活隧穿和渗流这两个纳米效应相互平衡的基本原理引纳米颗粒在电感和天线等无源器件中的应用，各向同性导电胶的纳米工程、纳米颗粒添加剂和表面增强处理，可印制解决方案的进展和纳米银的烧结（或激光烧结）高热导率的CNT微通道冷却器，CNT-聚合物复合材料，CNT锡铅共晶物和无铅焊料纳米管，线的各项应用 以及论述CMOS缩小极限（45nm或更低）下的具体封装问题。
《国际信息工程先进技术译丛·纳米封装：纳米技术与电子封装》特色：
1.国际知名纳米研究人员参与编写。
2.针对纳米封装材料和工艺技术众多方面的最新研究进行介绍，及时更新研究成果。
3.提供了大量的参考文献，为读者参考国内外相关研究情况提供了全面的背景资料。
4.提供系统的纳米材料在封装领域的各项应用。
5.系统讨论了纳米颗粒、碳纳米管在封装方面的应用特性。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com